



Kompozytowe płyty izolacyjne **termPIR® AL GK** składają się z płyty termPIR z rdzeniem z pianki **PIR** pokrytej obustronnie gazoszczelną okładziną warstwową na bazie papieru oraz aluminium oraz z płyty **gipsowo-kartonowej** o grubości 12,5 mm. Pomiędzy płytą z okładziną aluminiową, a płytą g-k znajduje się warstwa adhezyjna.

parametry płyty kompozytywnej termPIR® AL GK

właściwości		wartości / klasy					
Długość / szerokość		2,6 m (±10 mm) / 1,2 m (±7,5 mm)					
Grubość całkowita ($d_N + 12,5$ mm)		grubość d_N^* płyty termPIR z okładziną oraz grubość płyty karton-gips 12,5 mm					
Wspł. przewodzenia ciepła, λ_D	<i>dla $d_N^* = 25$ mm / +12,5 mm:</i>	0,022 [W/m·K]					
Opór cieplny, R_D		1,15 [W/m ² ·K]					
Wspł. przewodzenia ciepła, λ_D	<i>dla $d_N^* = 20 - 250$ mm / +12,5mm:</i>	0,022 [W/m·K]					
Opór cieplny, R_D [m ² ·K/W] dla pozostałych grubości		20 mm: 0,90	30 mm: 1,35	40 mm: 1,85	50 mm: 2,30	60 mm: 2,75	70 mm: 3,25
		80 mm: 3,70	90 mm: 4,15	100 mm: 4,65	110 mm: 5,10	120 mm: 5,55	130 mm: 6,05
		140 mm: 6,50	150 mm: 6,95	160 mm: 7,45	170 mm: 7,90	180 mm: 8,35	190 mm: 8,85
	200 mm: 9,30	210 mm: 9,75	220 mm: 10,2	230 mm: 10,7	240 mm: 11,1	250 mm: 11,6	
Reakcja na ogień (wyrób z zastosowaniem końcowym) Rozprzestrzenianie ognia		Klasa B-s1,d0 "nierozprzestrzeniający ognia" Dotyczy płyt termPIR® AL GK o grubość warstwy PIR 20-140 mm + 12,5 mm g-k. Podłoże: Każdy rodzaj podłoża niepalnego i drewnopodobnego. Mocowanie za pomocą klejenia (w tym również klejami palnymi). Możliwe mocowanie mechaniczne. <i>Szczegóły w klasyfikacji.</i>					
* Parametry cieplne dotyczą termoizolacyjnego rdzenia PIR wraz z okładzinami. W obliczeniach nie uwzględniono oporu cieplnego płyty gipsowo-kartonowej oraz oporu warstwy adhezyjnej.							

parametry płyty termPIR z okładziną aluminiową

Gęstość rdzenia PIR	30 kg/m ³	
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu, σ_{10}	<i>dla ($20 \leq d_N < 30$ mm):</i> ≥ 120 kPa, CS(10/Y)120	<i>dla ($30 \leq d_N \leq 250$ mm):</i> ≥ 150 kPa, CS(10/Y)150

parametry płyty karton-gips (na podstawie deklaracji producenta)

Reakcja na ogień	Klasa A2-s1,d0
Przewodność cieplna (dla grubości 12,5 mm)	0,25 [W/m·K]

Dostępne frezy: FIT(frez płaski), LAP(frez schodkowy), TAG(pióro-wpust)

Instrukcja montażu: Płyty montować za pomocą klejenia z dodatkowym mocowaniem mechanicznym (za pomocą wkrętów typowych jak do płyty g-k, o długości dobranej do grubości płyty i typu podłoża). Klej dobrać do rodzaju podłoża i okładziny płyty - zalecany klej poliuretanowy lub klej do styropianu. Zapoznać się ze specyfikacją kleju. Zalecana temp. montażu: 5 - 20 oC. Zapewnić stabilność podłoża. Przed montażem podłoże oczyścić i (opcjonalnie) zagruntować. Szczeliny dylatacyjne pomiędzy płytami g-k po montażu płyty zafugowuje się i zabezpiecza tak jak typową płytę g-k. Zostawić przerwę pomiędzy podłogą a płytą oraz zabezpieczyć przez podciąganiem wilgoci. Płyty przechowywać w warunkach suchych. Płyty nie są elementem nośnym.